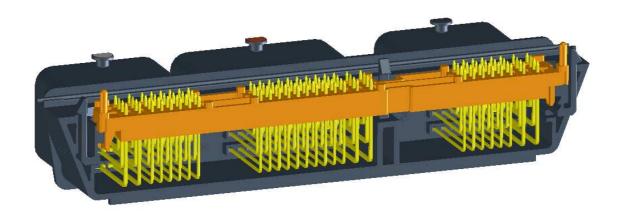


112ckt CMC Header - Soldering Version

112ckt CMC Header - Lötversion





REVISION	MODIFICATION	SHEET	DATE
1	First release	1-5	2008-11-12

REVISION:	ECR/ECN INFORMATION: EC No: G2009-0165 DATE: 2008 / 11 / 12	112 C	KT CMC HEADER DERING VERSION	_	1 of 5
DOCUMENT NUMBER: AS-64333-001		CREATED / REVISED BY: M. Balzer	CHECKED BY: J. Giuriato		OVED BY: Dietz

TEMPLATE FILENAME: APPLICATION_SPEC[SIZE_A4](V.1).DOC



1.0 SCOPE / ANWENDUNGSBEREICH

This Application Specification covers the CMC Header 112ckt. assembly operation on PC Board. Diese Anwendungsspezifikation umfasst den Zusammenbau des CMC Header 112ckt. auf die Leiterplatte.

2.0 PRODUCT DESCRIPTION / PRODUKTBESCHREIBUNG

Part name	Molex Part number		
Header 112ckt.	0643330100		

3.0 REFERENCE DOCUMENT / BEZUGSDOKUMENT

See the appropriate Customer drawings SD-64333-100 for information on dimensions, materials, and markings.

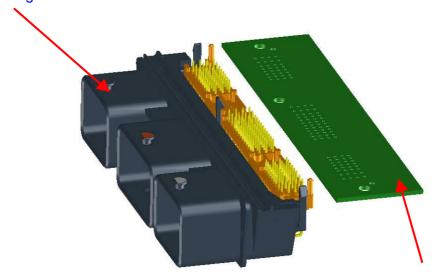
Siehe entsprechende Kundenzeichnung SD-64333-100 für Informationen über Maße, Material und Markierungen.

4.0 PROCEDURE / ABLAUF

4.1 ASSEMBLY INSTRUCTIONS / MONTAGEANLEITUNG

4.1.1 COMPONENTS GRIPPING / KOMPONENTENHANDHABUNG

- Take in one side the CMC header, pins and tabs soldering ends oriented upwards.
- Eine Seite nimmt den Header auf, die Spitzen der Löttabs müssen nach oben ausgerichtet sein.



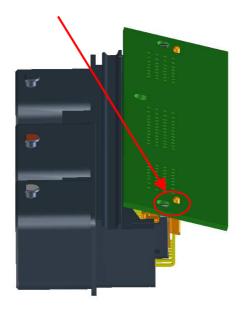
- Take in the other side the PC Board, appropriate holes located in front of the header pins.
- o Die andere Seite nimmt die Leiterplatte auf. Entsprechende Löcher müssen vor den Löttabs ausgerichtet sein.

REVISION 1	ECR/ECN INFORMATION: EC No: G2009-0165 DATE: 2008 / 11 / 12	112 0	KT CMC HEADER DERING VERSION	_	2 of 5
DOCUMENT NUMBER:		CREATED / REVISED BY: CHECKED BY: APPROVE		OVED BY:	
AS-64333-001		M. Balzer J. Giuriato		H.	Dietz
	TEMPLATE FILENAME: APPLICATION SPECISIZE A4I(V.1) DOC				CISIZE A41(V 1) DOC



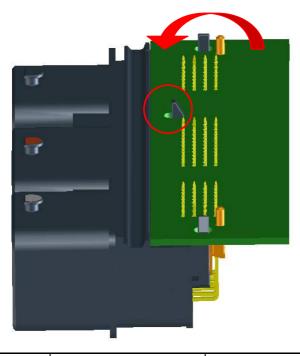
4.1.2 PC BOARD POSITIONNING / LEITERPLATTENPOSITIONIERUNG

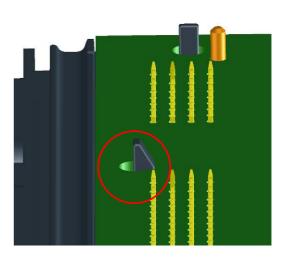
- Place the PC Board over the CMC header under an angle of maxi 30°. Make sure that the header positioning pegs are exactly inserted in the PC Board holes.
- Die Leiterplatte wird über dem CMC Header unter einem Winkel von max. 30° positioniert. Die Positionsdome des Headers müssen genau in die Leiterplattenlöcher eingelegt werden.



4.1.3 PC BOARD LOCKING / VERRASTUNG DER LEITERPLATTE

- Install the PC Board until the complete locking of the header locking pegs. The three locking latches must be fully locked.
- Montage der Leiterplatte bis alle Verrastungselemente des Headers verrastet sind.
 Die 3 Rasthaken müssen vollständig verriegelt sein.





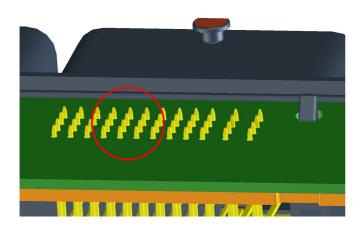
1	EC No: G2009-0165 DATE: 2008 / 11 / 12	112 6	KT CMC HEADER DERING VERSION	_	3 of 5
DOCUMENT NUMBER:		CREATED / REVISED BY: CHECKED BY: APPROVE		OVED BY:	
AS-64333-001		M. Balzer	J. Giuriato	H. Dietz	
TEMPLATE FILENAME: APPLICATION_SPEC[SIZE_A4](V.1).DOC					

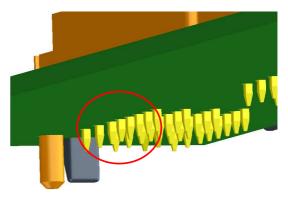


4.2 CHECKING PROCESS / KONTROLLE DES PROZESSES

4.2.1 SOLDER PIN POSITION CHECK / ÜBERPRÜFUNG DER LÖTPINPOSITION

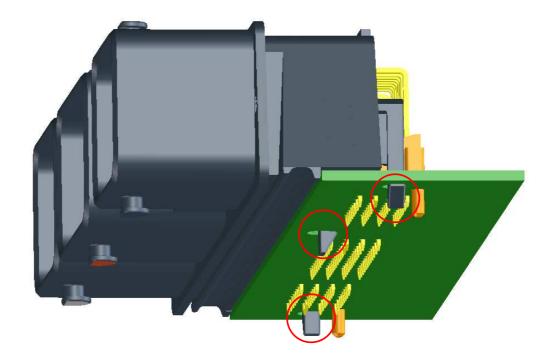
- o All 112 solder pins must protruding minimum 1.00 mm out of the PC Board.
- o Alle 112 Lötpins müssen mindestens 1.00 mm aus der Leiterplatte herausragen.





4.2.2 LOCKING LATCHES POSITION CHECK / ÜBERPRÜFUNG DER RASTHAKENPOSITION

- All 3 locking latches must be fully locked in the PC Board holes and the header must be fully seated on it.
- Alle 3 Rasthaken müssen vollständig in der Leiterplatte verrastet sein und der Header muss vollständig aufsitzen.



REVISION:	EC No: G2009-0165	112 CKT CMC HEADER SOLDERING VERSION		4 of 5	
•	DATE: 2008 / 11 / 12				
DOCUMENT NUMBER:		CREATED / REVISED BY: CHECKED BY: APPROVE		OVED BY:	
AS-64333-001		M. Balzer	J. Giuriato	H. Dietz	
TEMPLATE FILENAME: APPLICATION_SPEC[SIZE_A4](V.1).DOC					



5.0 STORAGE CONDITIONS / LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Storage temperature: -20°C to 60°C

Lagertemperatur: -20°C bis 60°C

o Stock age duration: 12 months after delivery date

o Lagerzeit: 12 Monate nach Lieferung

REVISION:	ECR/ECN INFORMATION: EC No: G2009-0165 DATE: 2008 / 11 / 12	112 CKT CMC HEADER SOLDERING VERSION		<u>SHEET No.</u> 5 of 5	
DOCUMENT NUMBER:		CREATED / REVISED BY: CHECKED BY: APPL		APPR	OVED BY:
AS-64333-001		M. Balzer	M. Balzer J. Giuriato H		Dietz

TEMPLATE FILENAME: APPLICATION_SPEC[SIZE_A4](V.1).DOC

C-G-01110-A2